

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-009

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	银丰创投：王炳光；嘉融投资：刘胤之、高春华；东方资产：高原、胡霜、张智宣、刘世佳、周晓、苏恒、张浩；浙江永禧：李诗陶；杭州济海：徐珊、张周鹏；国海证券：徐子璐；银河投资：吕云龙；北京汇信恒宝：张舒涵；鞍钢集团：张雷、孙喆；杭州心远私募：陈家乾；鲁花投资：刘实；黑龙江辰能资本：杨国凯、刘加奇；申万菱信基金：徐巡；湖北省铁路发展基金：谢天羽；国海投资：赵冰寒、侯海斌；国家绿色发展基金：胡雅娟；积发基金：谢桂；北京富弘荣宸：陈坚峤；吉富创投：王誉轩；财通基金：刘佳蒙；北京磐泽：施巧瑜；杭州嘉星：赵孙、钟昶；上海玖普：吕哲；福建省产业股权投资：陈正浩、郑季丰
时间	2026 年 7 月 17 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况 通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。 公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024

年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年第一季度分别实现营收 222.69 亿元、238.82 亿元、279.21 亿元和 74.82 亿元。公司 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年第一季度的归母净利润分别为 1.69 亿元、6.78 亿元、12.19 亿元和 3.29 亿元。

二、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：公司今年半年度情况如何？

回复：2026 年上半年，在 AI 算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。

公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。

此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2026 年上半年业绩。公司已于 2026 年 7 月 15 日披露《2026 年半年度业绩预告》，2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 160,000-180,000 万元，比上年同期增长 288.26%-336.80%；扣除非经常性损益后的净利润为 70,000-80,000 万元，比上年同期增长 66.49%-90.28%。

问题 3：请问本次向特定对象发行股票审批到什么阶段了？

回复：本次向特定对象发行股票方案已经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册。公司董事会将按照相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

问题 4：简单介绍一下半导体行业的周期特点。

回复：半导体产业具有技术呈周期性发展、市场呈周期波动的特点。受摩尔定律的制约，半导体产业的发展必然会有技术、时间和价格的波动，经过一段长时间的高速增长后，增速趋缓属于产业的正常调整。集成电路封测行业的需求与宏观经济的发展以及下游行业的景气度密切相关，在宏观经济上行周期时，下游行业景气度较高，集成电路封测企业产能利用率趋于饱和，经营业绩增长；在宏观经济下行周期时，下游行业景气度较差，集成电路封测企业产能利用率趋于不足，经营业绩下滑。

问题 5：请简单分析一下本次募投项目“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”有关的公司技术储备。

回复：公司在汽车电子封装测试领域深耕多年，较早即导入并通过符合全球汽车行业主流标准的质量管理体系认证。自 2005 年顺利通过 ISO/TS16949 质量体系认证以来，公司持续按照车规要求优化生产及质量控制流程，形成覆盖研发、生产、测试及供应链管理的全流程质量管理体系。依托上述体系基础，公司在车载芯片温度范围宽、工作寿命长等特殊应用要求下，持续精进封测工艺与质量控制能力，已实现满足 AEC 规范中 Grade 0 等高可靠性等级要求的高端汽车电子产品封装，为本次进一步拓展车载

	芯片封测产能奠定了坚实的体系与经验基础。 依托在车规产品领域长期积累的技术优势与质量口碑，公司已成为车载芯片本土化封测的重要参与者，具备面向车载芯片产品的解决方案能力，并与多家海内外头部企业形成稳定合作关系。公司在车规领域多年的产品验证与客户协同开发经验，使其能够更好理解车载芯片对功能安全、可靠性验证及生命周期管理的综合要求，在新项目导入、样品验证、大批量生产等环节与客户形成高效协同。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 17 日